

公司名稱	貿聯國際股份有限公司	聯絡人	HR
地址	新北市中和區建八路2號6樓之1		
電話	02-8226-1000	傳真	02-8226-1111
電子郵件	caron_su@bizlinktech.com		
職務名稱	軟體工程師 硬體工程師	人數	軟體工程師 2 人 硬體工程師 2 人
工作性質	研發類		
所需科別	機電整合所 電機所 車輛工程所 資訊工程所		
需求性質	應屆畢業生	其它條件	請提供論文等相關作品
工作地點	新北市中和區	起薪	面議
公司簡介:	<p>貿聯集團(BizLink)創於 1996 年，總部設於美國加州矽谷(Fremont, California)，2011 年以 F-貿聯 在台灣證券交易所上市，代號 3665。貿聯的業務源於 ICT 連接線與光纖應用線材，2001 年拓展到車用線、醫療線、太陽能連接設備以及工業用線。</p> <p>貿聯主要客戶在歐美，專注服務全球各領域的一線品牌商，在 ICT 產業有 Dell、HP、Microsoft、SONY 與 Cisco 等，醫療產業有 GE Healthcare、Siemens Healthcare 與 Abbott Labs 等；在汽車產業有 BMW、Tesla 與 Yazaki 等；在工控儀測產業則有 National Instruments、Tektronics 與 Agilent 等。</p>		